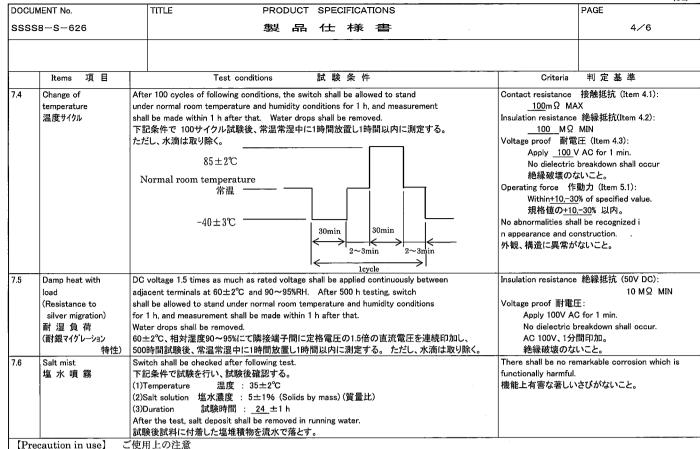
DOCU	MENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	
sss	S8-S-626	S-626 製 品 仕 様 書		1/6	
BACK	GROUND			(s)	
1. Gen	eral 一般事項				
1.1 A	pplication 適用範囲	This specification is applied to low current circuit (Secondary circuit) slide switch used for ele	ctronic equipment.		
		この仕様書は主として電子機器に用いる低電流回路用(2次側回路用)スライドスイッチに適用			
1.2 O	perating temperature r	ange 使用温度範囲 : −40 ~ 85℃ At high temperature and low temperature, this shall be according to operating life with load			
		(Cold – Dry heat) in item 7.1 and 7.2.			
		但し、高温・低温においては、7.1項 耐寒性 7.2項 耐熱性 の条件による。			
	torage temperature ran est conditions 試験状		e as follows		
' ''	est conditions page	試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。	c as follows.		
		Ambient temperature 温 度:5~35℃			
	•	Relative humidity  相对湿度 :25~85% Air pressure    気  圧 :86~106kPa			
		Should any doubt arise in judgement, tests shall be conducted at the following conditions.			
		ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。			
		Ambient temperature 温  度 : 20±2°C Relative humidity  相対湿度 : 60~70%			
		Air pressure 気 圧:86~106kPa			
		nd dimensions 外観、構造、寸法			
2.1 A <sub> </sub>	ppearance 外観	Switch shall have good finishing, and no rust, crack or plating failures. 各部の仕上げは良好で、機能上有害な錆、傷、割れ、めっき不良及び剥離等があっ	ってはならない。		
2.2 C	onstruction and dimens		2 (10. 5. 5 5.0 )		
3.Ratin		Maximum 最大定格 <u>5</u> V DC <u>0.3</u> A (Resistive load)(抵抗負荷)			
4 Flec	i trical specification 電	Viinimum 最小定格 <u>3 V DC 50 μ</u> A (Resistive load)(抵抗負荷) ·(氧的性能			
1. 2.00	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準	
4.1	Contact resistance	Shall be measured at 1 kHz±200 Hz (20 mV MAX, 50 mA MAX)	70 mΩ MAX		
	接触抵抗	1 kHz±200 Hz、電圧 20 mV 以下、電流 50 mA 以下による方法。			
4.2	Insulation	Test voltage: 100 V DC, measured after 1 min ± 5 s	100 MΩ MIN		
	resistance	Applied position: Between all terminals			
	絶 縁 抵 抗	Between terminals and ground(frame)			
		DC100V の電圧を 1分±5秒間端子相互間、端子フレーム間に印加し、測定する。			
4.3	Voltage proof	Test voltage: 100 V AC (50~60Hz, cut-off current 2 mA)	No dielectric breakdo	own shall occur.	
	耐電圧	Duration: 1 min	絶縁破壊のないこと。		
		Applied position: Between all terminals			
		Between terminals and ground(frame) AC 100 V (50~60Hz、感度電流 2 mA) の電圧を 1分間端子相互間、端子フレーム間に			
		印加する。			
4.4	Changeover timing		Refer to individual pr	oduct drawing.	
	切換タイミング		個別製品図による。		
5. Mec	hanical specification	機械的性能			
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準	
5.1	Operating force	A static load shall be applied to the root of actuator in operating direction.	Refer to individual pro	oduct drawing.	
	作動力	操作部の根元に作動方向へ静荷重を加えて測定する。  □   □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □	個別製品図による。		
		<del> </del>			
5.2	Robustness of	A static load of 3 N shall be applied to the tip of terminal in a	Shall be free from ter		
	terminal 端 子 強 度	Desired direction for 1 min. The test shall be done once per terminal. 端子先端の一方向へ 3 N の静荷重を1分間加える。	damage and breakage Terminals may be ber	of terminal holding portion.	
	7 JEL 150	ただし、回数は1端子当たり1回とする。	Electrical performance requirement specified		
				n item 4 shall be satisfied.	
				び端子保持部の破損のない 曲がりは差し支えないも	
				する。また、試験後 4項の電気的性能を満	
			足すること		
	Robustness of	A static load of 10 N shall be applied in the operating direction	Shall be free from prodeformation and med	· ·	
	actuator		deformation and mechanical abnormalities. 著しいガタ及び曲がりのないこと。		
	A static load of 10 N shall be applied in the pull direction of actuator for 15 s. 操作部の引張方向に 10 N の静荷重を 15 秒間加える。 A static load of 5 N shall be applied in the perpendicular direction			- · · ·	
				•	
	of operation at the tip of actuator for 15 s. 操作部の先端に作動方向と直角に <u>5 N</u> の静荷重を 15 秒間加える。				
			APPD.	CHKD. DSGD.	
			Feb.23,2012	Feb.23,2012 Feb.23,2012	
	SYMB BACKGROUND ELECTRIC CO., LTD.	DATE APPD CHKD DSGD PAGE SYMB BACKGROUND DATE APPD CHKD DSGI	F.Yasuda	F.Yasuda T.Umezu	
ヘトプン	LLLOTINO OU., LID.				

Doci	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE (SL)
SSSS8-S-626		製品 仕様 書		2/6
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
5.4	Wobble of actuator 操作部の振れ	Run-out(P-P) shall be measured by applying a static load of 1 N in the perpendicular direction of operation at the tip of actuator. 操作部の先端に作動方向と直角に 1 N の静荷重を加え、振れ幅(最大値)を測定する。	P-P: 1 mm MAX	
5.5	Vibration 耐 振 性	Switch shall be secured to a testing machine by a normal mounting device and method. Switch shall be measured after following test. スイッチを正規の取付用具、取付方法で試験機に固定し、下記条件で試験を行い、試験後測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲:10~55 Hz (2)Total amplitude 全振幅:1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合:10-55-10 Hz Approx. 1 min 約1分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or linear 掃引振動数の変化方法 対数又は直線近似 (5)Direction of vibration:Three perpendicular directions including actuator 振動の方向 操作部を含む垂直3方向 (6)Duration 振動時間:2 h each (6 h in total) 各 2時間(計 6時間)	「70 mΩ M Insulation resistance 100 MS MS Voltage proof 耐電 Apply 100 No dielectric l 絶縁破壊のな Operating force 作り Within specific 規格値内とす No abnormalities shalin appearance and co	絶縁抵抗(Item 4.2): 2 MIN 圧 (Item 4.3):V AC for 1 min. oreakdown shall occur. :いこと。 助力 (Item 5.1): ed value. る。 Il be recognized
5.6	Shock	※ 前処理としてリフロー半田耐熱ストレスを加えるものとする。 Switch shall be measured after following test.	外観、構造に異常が Contact resistance	ないこと。 接触抵抗 (Item 4.1):
5.0	耐衝擊性	Switch shall be measured reter following test.  「1)Mounting method 取付方法: Normal mounting method 正規の方法で取り付ける。  (2)Acceleration 加速度: 980 m/s² (3)Duration 作用時間: 11 ms (4)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (5)Number of shocks 試験回数: 3 times per direction (18 times in total)  各方向各3回(計18回)		MAX 絶縁抵抗(Item 4.2): ? MIN 旺 (Item 4.3): VA for 1 min. by Ak(down shall occur. にいこと。 助力 (Item 5.1): sd value. る。
	※ 前処理としてリフロー半田耐熱ストレスを加えるものとする。		外観、構造に異常が	
5.7	Solderability はんだ付け性	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1)Solder はんだ:Sn-3.0Ag-0.5Cu (2)Flux フラックス: EC-19S-8 (3)Soldering temperature はんだ温度: 245±5 °C Immersing time 浸漬時間: 5±1 s Flux immersing time shall be 5~10 s in normal room temperature. ただし、フラックス浸漬は常温で5~10秒とする。	covered with solder. Cutting section of fr	immersed part shall be rame shall not be applied %以上がはんだで覆われて よ適用しない。
5.8	Resistance to soldering heat はんだ耐熱性	Switch shall be measured after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1)Solder はんだ:Sn-3.0Ag-0.5Cu (2)Flux フラックス: EC-19S-8  Re-flow soldering リフローはんだの場合  1. Heating method: Double heating method with infrared heater 加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。 2. Temperature measurement: Thermocouple ゆ0.1~0.2 CA(K) or CC(T) at switch body. 温度測定方法: ゆ0.1~0.2 の CA(K) または CC(T) を用い測定。位置はSW本体表面とする。 3. Temperature profile: Twice, however it shall be going back to normal room temperature between each test. 温度プロファイル 2回リフローとする。但し、1回リフロー後、常温に戻すこと。  (*C) Surface of product Temperature  部品表面温度 230  180 150  120sec.MAX  Peak Temperature  ### Temperature  ###################################	performance requirer 4 shall be satisfied. 外観に著しい変形の	ation. The electrical nents specified in item
		Wattage of soldering iron Diameter of soldering iron tip Temperature of soldering iron tip Soldering time Above conditions shall be applied to Glass fabric base, epoxy resin P.C.B of 0.3~0.8 mm thick. Soldering iron shall be put at the tip of terminals and prevented excessive force to the terminals. 上記の条件は、t0.3~0.8 mm のガラス基材エポキシ樹脂積層板について適用する。また、はんだごでは端子先端に当て、端子に異常加圧のないこと。		

	MNT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
SSS	88-S-626	製品 仕様書	3/6
lura	bility 耐久性能	 (前処理としてリフロー半田耐熱ストレスを加えるものとする。)	
/ui a	,		
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
1	Operating life	10,000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 15~20 cycles/min	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	without load 無負荷寿命	without load	100_mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2):
	無 貝 何 芽 叩	無負何に C10,000 9 1 9 7 7 (製)TF 还及 13~20 9 1 7 7 7 2 2 2 2 3 1 7 7 7 2 2 2 3 1 7 7 7 2 2 2 3 1 7 7 7 7 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	10 MΩ MIN
			Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3);
			Apply 100 V AC for 1 min.
			No dielectric breakdown shall occur.
			絶縁破壊のないこと。
			Operating force 作動力 (Item 5.1):
	ł		Within+10,-30% of specified value.
	ľ		規格値の+10,-30% 以内。
	1		No abnormalities shall be recognized
			In appearance and construction
			外観、構造に異常がないこと。
.2	Operating life	10,000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 15~20 cycles/min	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
.2			,
	with load	with 5 V DC, 0.3 A.	
	負荷寿命	DC_5_V, 0.3_A(抵抗負荷)にて10,000サイクル(動作速度15~20 サイクル/分)連続動作を行う。	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2):
	İ		
	l		Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3):
	l		Apply 100 V AC for 1 min.
	l		No dielectric breakdown shall occur.
	l		絶縁破壊のないこと。
	l		Operating force 作動力 (Item 5.1):
	l		Within <u>+10,-30</u> % of specified value.
	l		規格値の <u>+10,-30</u> % 以内。
	l		No abnormalities shall be recognized
	l		in appearance and construction.
	L		外観、構造に異常がないこと。
.Envir	ronmental test 耐候性	t (前処理としてリフロー半田耐熱ストレスを加えるものとする。)	
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
'.1	Cold	After testing at -40±2°C for 500 h, the switch shall be allowed to stand under	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐寒性	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement	100 mΩ MAX
		shall be made within 1 h. Water drops shall be removed.	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2):
		-40±2℃にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	10 MΩ MIN
		ただし、水滴は取り除く。	Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3):
			Apply 100 V AC for 1 min.
			No dielectric breakdown shall occur.
			絶縁破壊のないこと。
			Operating force 作動力 (Item 5.1):
			Within+10,-30% of specified value.
	1		規格値の+10,−30% 以内。
	l .		
			No abnormalities shall be recognized in appearance and construction.
			No abnormalities shall be recognized
.2	Dry heat	After testing at 85±2°C for 500 h, the switch shall be allowed to stand under	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction.
.2	Dry heat 耐 熱 性	After testing at 85±2°C for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。
'.2			No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):100m \Omega MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2):10M \Omega MIN
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
7.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗(Item 4.1):
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
7.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
'.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
7.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
.2		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
		normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにで500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにで500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°C(こで500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。  Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed.	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐熱性 Damp heat	normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2°Cにて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。  After testing at 60±2°C and 90~95%RH for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 60±2°C、相对湿度90~95%にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定	No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。 Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):



## A. General 一般項目

A1. The content that this Products guarantees is a test conditions described in this specifications. Please actually confirm there is no problem in your set when you use it.

当製品の保証範囲は、当製品仕様書に記載の試験条件となります。実際にご使用の際は、貴社セットにて問題の無いことをご確認願います。

A2. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A3. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。 また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれが ある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。

A4. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medicalquipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、 製造されたものです。 したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。 上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は 弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、 誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

- A5.Do not operate switches continuously at extremes of high and low temperatures of the specified temperature range. The maximum operating duration under the specific environmental conditions is specified in the part specifications. 使用温度範囲の上限付近及び下限付近での長時間の連続使用は出来ませんのでご注意下さい。使用条件の規定は製品仕様書の各種環境試験の範囲内と なりますのでご注意下さい。
- A6.The specified operation life is determined at the temperature between 5□ and 35□, not at temperature extremes 動作寿命の規定は、常温(5~35℃)によるもので使用温度上限及び下限付近での連続動作は出来ませんのでご注意下さい。
- A7. When switches are to be operated at temperature extremes continuously, we need to examine each specification whether it is possible. 使用温度上限及び下限付近で連続動作を行う場合は、機種毎に仕様規定が可能かどうかの確認が必要となりますのでご注意下さい。
- A8. Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。 A9. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current.

If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

別途ご相談ください。

			(52)
DOCUMNT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
SSSS8-S-626		製品仕様書	5/6

- B. Soldering and assemble to P.C. Board process はんだ付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2.Use of water-soluble soldering flux shall be avoided because it may cause corrosion of the switch. はんだ付けの際、水溶性フラックスはスイッチを腐食させるおそれがありますのでご使用はお避けください。
- B3. Condition of re-flow soldering flux shall be confirmed with actual production conditions. リフローはんだ条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B4. As this switch is designed for re-flow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding. 当スイッチはリフローはんだ対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが侵入する恐れが ありますので、十分にご注意ください。
- B5. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. はんだ付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- C.Mechanism design(switch layout) 機構設計
- C1. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

、スイッチ操作部に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合があります。スイッチに規定以上の荷重が加わらないようにご注意下さい。 (操作部強度参照)

- C2.Designing printed pattern and parts layout shall be considered because the characteristics may change due to warp of P.C.Board. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。
- C3. Please do not take the stress on the switch, when operate the switch. スイッチ使用時、スイッチ上面には荷重がかからない様ご配慮ください。
- C4. When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection.

Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area.

本スイッチをリフロー半田後,プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は,ディップ時のフラックス吹き上げ等により,スイッチ側面より, フラックスがはい上がる場合がありますので,パターン設計にあたっては,スイッチ下面,周囲にスルーホールを設けないで下さい。

- C5. Note that the pattern or resist from on the switch mounting surface of the P.C.B may have an effect on the soldering because of those
- スイッチ取付面にあたるプリント基板のパターンやレジストの形状により、その厚み分が半田付け性に影響する場合がありえますのでご注意願います。
- C6.Care should be taken to assure that excess force is not applied on the actuator because it is small and weak when P.C.B. are stacked or For miniature or low profile switches, do not give impact or excess force on them during assemble processes. transported 操作部は小さいため強度が弱くなっておりますので、工程内のP.C.B.の重ねや搬送時、操作部に力が加わらないようご注意下さい。

特に小形、薄型のスイッチはセット取付け工程において外力が加わらないようご注意ください。

C7.Please note that the solder going up occurs if the pattern of ground terminal is set in the main body of the product. アースタンシ部のパターン設計においては、製品本体の内側に設定しますと、半田上がりの恐れがありますので、十分考慮願います。

C8. Operate switches with full travel as much as possible.

押し込み移動量は出来るだけ全移動量に近い位置で、ご使用していただくようご注意願います。

- D. Using environment 使用環境
- D1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは完全密閉構造ではありませんので,使用環境によっては塵埃が内部に侵入し,接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust. The followings are examples of dust invasion: ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意下さい。 以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

- (1)Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.
- 工程内におけるPCB切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙、発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。
- (2)Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

- D2. If you use this product in one of the following environmental conditions, progress of sulfuratio and oxidization on the contact part will be accelerated, which may cause contact failure. Therefore, be careful about the supposed environment.
  - 以下の様な環境下で使用されますと、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご使用を避けてください。
  - (1) Around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated. And in case this products is always used in the place where the exhaust gas and the corrosion gases such as  $H_2S$ ,  $SO_2$ ,  $NO_X$ ,  $Cl_2$ ,  $NH_3$ ,  $HNO_3$  are generated.

硫黄系温泉地や自動車の排気ガス等、H2S、SO2、NOx、Cl2、NH3. HNO3等の腐食性ガスが発生する場所で常時使用する場合。

In atmospheres of dew condensation, adhesive water drops,

水滴が付着する環境や、結露が発生する環境。

In liquid such as water, salt water, oil, chemicals and organic solvent.

塩水や油、薬品、有機溶剤等の液体中。

In location exposed to direct rays of the sun.

直射日光の当たる場所。

In dusty location. 塵埃の多い場所。

- (2) Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下のような部材に関しましては以下の点にご注意願います。
  - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
    - 部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化,酸化ガスを発生しないものを採用して下さい。
    - When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure. シリコン系ゴム,グリース,接着剤,オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。

低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の皮膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

DOCUMNT No.	TITLE PROI	DUCT SPECIFICATIONS PAGE	
SSSS8-S-626	製	品仕様書	6/6
-			

E. Storage method. 保管方法

- E1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温,常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から 6 ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用下さい。
- E2. Storage conditions the switches packed before being mounted.

実装前、梱包状態での保管条件

Temperature 温度:-5~35℃ Humidity 湿度:35~85%RH

- E3. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.
- 開封後はポリ袋で外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- E4. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- F. Others. その他
- F1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又は発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- F2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own direction.

  電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめご了承下さい。
- F3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生の恐れがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- F4. It is recommended to install a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the equipment requiring expensive safety, whatever purposes the equipment is applied for. 用途の如何にかかわらず、高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図られると同時に、お得意先において安全性のテストをされることをお勧めします。
- F5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring special safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing that fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしてますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

